



PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	DCOBRA4830_POW_V1	焊接	QM0332021122001	V3	2/3	20211025

## 2. 焊接顺序：贴片元件→镀锡焊盘→接插件→单股硬铜线→MOS 管（功率管）

1) 温感热敏电阻 RT1 紧贴 PCB 的下表面焊接（见右图）；

2) BV 单股硬铜线焊接要求：

a) MH7 与 MH8 间（1 根六平方，总长 67mm，在底层红色覆盖区，见右图）

b) MH9 与 MH10 间（1 根六平方，总长 27mm，绿色覆盖区）

c) MH1\_PW1 与 MH2\_PW1 间

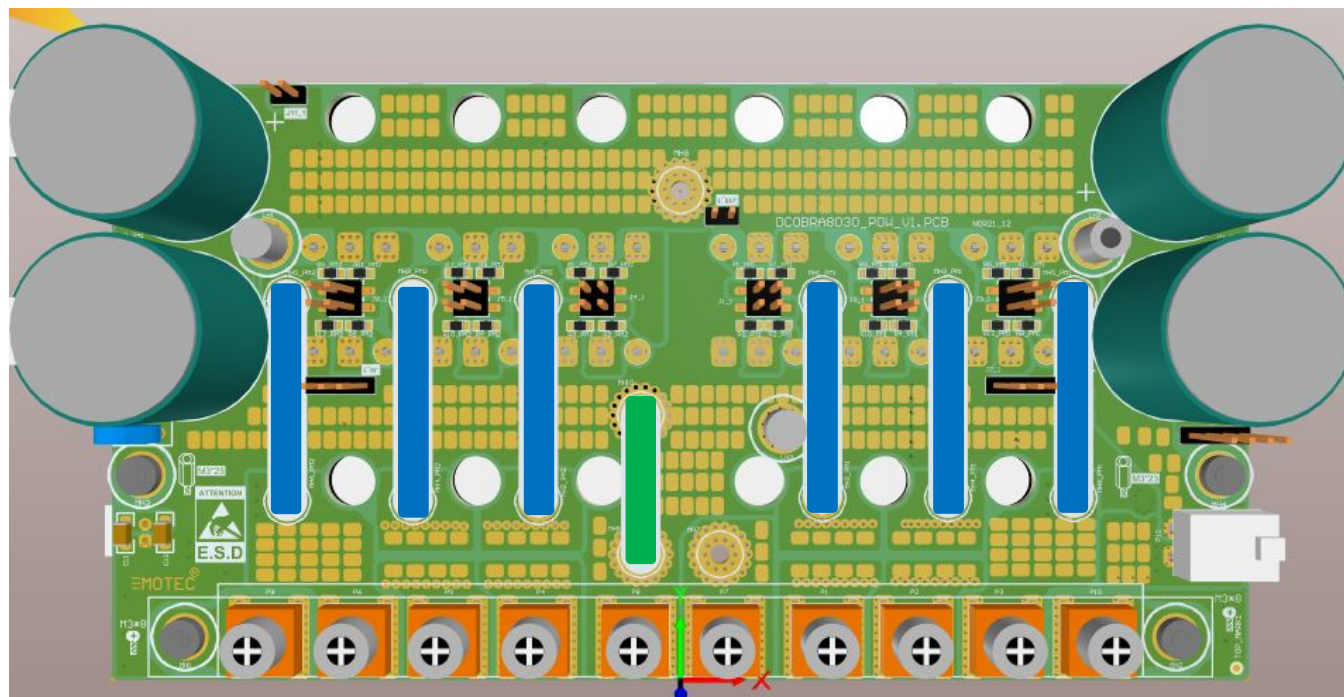
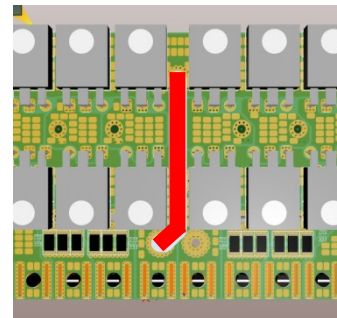
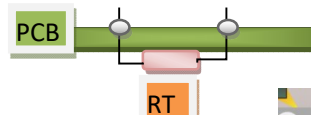
MH3\_PW1 与 MH4\_PW1 间

MH5\_PW1 与 MH6\_PW1 间

MH1\_PW2 与 MH2\_PW2 间

MH3\_PW2 与 MH4\_PW2 间

MH5\_PW2 与 MH6\_PW2 间（共计 6 根六平方，总长 40.5mm，蓝色覆盖区）



### 注意事项：

a) 2) \_a) 和 2) \_b) 项单股硬铜线紧贴线路板焊接，2) \_c) 项单股硬铜线抬高 2mm 焊接；

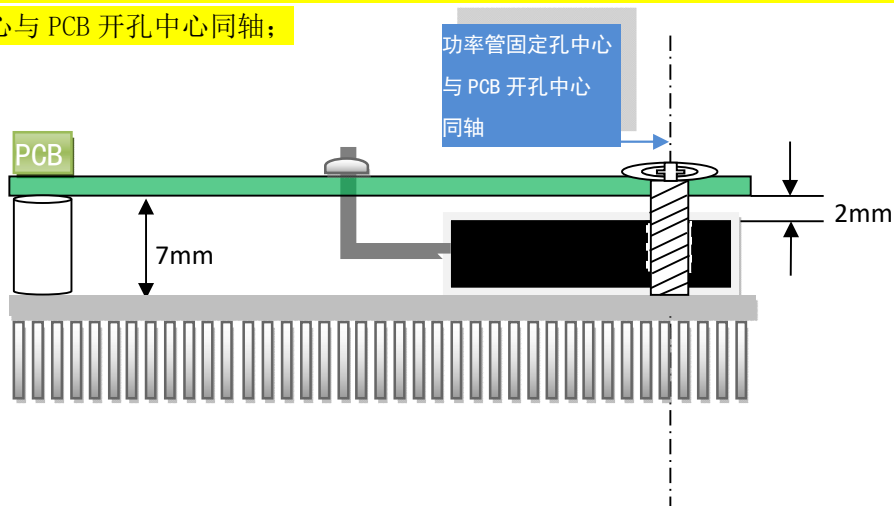
b) 单股硬铜线管脚完全浸润焊锡，严禁虚焊，空焊，管脚长度剪切后为 1.2mm 以内；

c) P1~P10 功率端子焊接，要求压到底，完全浸润焊锡，严禁虚焊，空焊；

3) 功率管 Q1\_PM1~Q6\_PM1 及 Q1\_PM2~Q6\_PM2 共计 12 个（TO-247 封装的管子），管脚直角折弯


a) 高度：功率管的下表面（金属部分）距离 PCB 下表面 7mm 焊接；且要求功率管脚顶层和底层双面焊接；

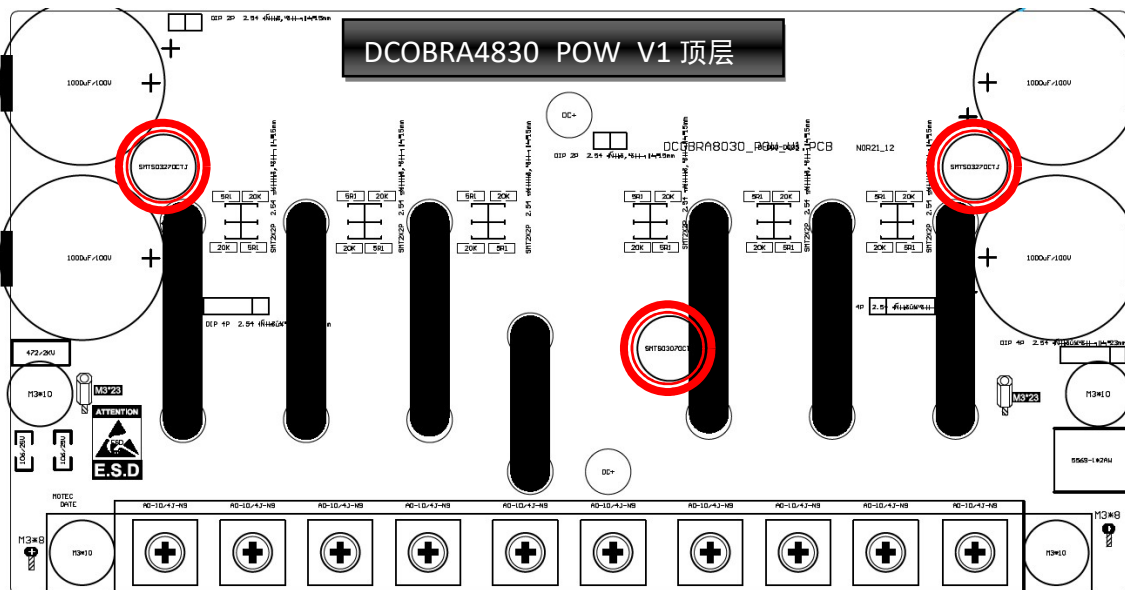
b) 焊接后，功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴；



PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	DCOBRA4830_POW_V1	焊接	QM0332021122001	V1	3/3	20211220

4) 贴片螺母焊接要求:

- a) LH1~LH3 位置焊接 SMTS03270CTJ ( M3\*7 不带螺纹支撑柱) 
- b) 贴片螺母要求落到底焊接, 保证焊接后螺母垂直于 PCB, 同时焊盘圆周上的过孔注满锡 (见下图);
- c) 贴片螺母的顶端不能有沾锡;



- 5) 所有端口插座焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 6) 所有极性元件, 严禁方向反;
- 7) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;
- 8) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;
- 9) 手工操作要做防静电处理;
- 10) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;
- 11) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	